

# 다국적기업의 반도체산업에 대한 전략적 제휴에 관한 고찰

최종수\* · 김헌종\*\*

## A Review of Strategic Alliance on the Film in the Semiconductor Industry

Choi, Jong-Su\* · Kim Hun-Jong\*\*

### 〈목 차〉

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| I. 서론                      | V. 반도체 산업의 제휴현황       |
| II. 전략적 제휴가 이루어지는 이유       | VI. 국가차원의 제휴전략 추진현황   |
| III. 전략적 제휴의 범주와 사례        | VII. 최근 국제 전략적 제휴의 특성 |
| IV. 반도체산업의 전략적 제휴와<br>향후전망 |                       |

### 요점

전략적 제휴는 세계적 추세인 기업경영 국제화의 핵심전략이 되고 있다. 2자간, 일방적 제휴의 특성을 가진 과거의 제휴와 달리 전략적 제휴는 다자간, 쌍 방적 특성을 가지며, 특히 외부기업의 경영자원을 일정한 기간, 일정한 목적 하에 활용하려는 전략적 특성을 가진다. 전략적 제휴의 동기는 R&D비용 및 분산, 신 공정 및 신제품의 신속한 개발 및 확보, 경영자산의 공유, 시장 진입 및 확대, 경쟁방식의 조정 등 매우 다양하다. 제휴의 형태도 경영의 전 과정 및 전 영역을 포함하고 있으며, 참여기업의 수가 증가함에 따라 매우 복잡한 국제적 네트워크를 형성하는 방향으로 나아가고 있다. 세계의 전략적 제휴는 미, 일, 유럽 등 3국간에 집중되어 있으며, 거대한 기술력과 자본력을 가진 선진국 대기업간에 가장 활발히 전개되고 있다. 대기업과 중소기업의 제휴는 중소기업이 특유한 기술을 보유하고 있는 기술집약기업이거나 OEM을 담당할 수 있는 생산능력을 보유한 기업인 경우에 대부분 대기업의 주도로 이루어지고 있다. 전략적 제휴는 손실과 이득을 동시에 수반한다. 각국 정부는 전략적 제휴의 이득이 크다

\* 한국해양대학교 국제무역경제학부 교수  
\*\* 한국해양대학교 국제무역경제학부 강사

는 인식 하에 독과점 규제법규나 공정거래 법규를 느슨하게 적용함으로써 기업의 전략적 제휴를 간접적으로 조장하는 기업환경을 조성하거나, 국가가 관여하는 공동기술 개발프로그램을 형성하여 직접적으로 기업간의 기술제휴를 비롯한 각종 형태의 제휴를 유도함으로써 전략적 제휴를 강화하는 정책을 사용하고 있다. 전략적 제휴는 기업 경영 국제화의 핵심적 전략이기도 하다. 특히 기술선진국들이 추진하고 있는 전략적 기술제휴 네트워크에 참여하지 못하는 경우에는 독자적 개발이 불가능한 차세대 첨단 기술의 획득이 차단될 우려도 있다. 세계시장과 경영자원을 활용하지 못하면 그 만큼 경쟁우위를 상실하게 된다. 반도체의 경우와 같이 한국기업들의 제휴는 주로 OEM 에서부터 시작하여 도입기술과 생산력의 결합 국내, 외 시장과 외국자본 및 국내생산력의 결합을 목적으로 한 합작투자, 자체기술 개발력의 향상에 의한 세계적 기업들과의 전략적 제휴로 발전하는 과정을 밟아왔다. 우리 나라 기업의 전략적 제휴를 강화하기 위해서는 먼저 전략적 제휴를 경영전략의 핵심으로 인식하여 장기적인 관점에서 단계화 하여 추진하되 최적 대안을 선정 할 수 있는 능력을 갖추도록 하며, 제휴선 및 제휴수단은 다변화하도록 하여야 한다. 전략적 제휴란 민간주도하에 추진되는 것이므로 정부의 정책적 개입의 여지가 많지 않으나, 정부는 한국기업의 국제화와 외국기업의 한국진출 및 제휴 강화, 확대를 장려하는 각종 직, 간접 지원정책을 사용할 수 있으며 긍정적 규제완화정책으로 신 경제정책의 취지에 부응하여야만 된다. 한국기업에게 있어서 전략적 제휴에 관한 국내기업들의 인식과 정보가 제한되어 있기 때문에 이 분야에 대한 연구와 홍보가 절실하며, 선진국 및 경쟁국의 전략적 제휴 동향에 대한 정보 수집, 확산 등이 정부의 지원 하에 추진되어야 할 과제이다. 한국기업에 있어서 전략적 제휴는 이제부터 본격적으로 시작되는 새로운 분야라 할 수 있다. 전략적 제휴의 강화를 뒷받침하기 위해서 이에 대한 보다 정확한 현황분석을 비롯하여 보다 많은 연구가 필요하다.

## I. 서 론

글로벌 라이제이션이 진행됨에 따라 경영환경이 과거와는 비교 할 수 없을 정도로 빨리 변하고 있다. 21세기에는 과거의 규칙이나 질서가 붕괴돼 불확실성이 높아지고 가치관의 다양화가 진전되는 것이 특징이다. 기업의 경쟁상태가 수시로 바뀌고 경쟁규칙 자체도 급변한다. 일본의 닛케이비즈니스에 따르면 기업의 평균수명이 30년으로 보며, 21세기의 기업의 수명은 이보다 훨씬 짧아질 것이 분명하다. 국경 없는 “메가 컴피티션 (Mega-competition. 대 경쟁)의 시대”에 살아남을 수 있는 길은 무엇 일 까.

21세기 환경 변화의 특징은 디지털화에 따라 사이버 세계가 본격적으로 등장하고(디지털화), 기술이 과거와는 비교 할 수 없을 정도로 급속하게 발전하며(기술발전의 가속화), 경제적 국경개념이 없어진다(글로벌 화)로 요약 할 수 있다.

선진일류기업들은 디지털 경제의 도래라는 21세기 초반의 메카 트렌트에 대응, 새로운 수익과 성장의 원천을 찾아 변신을 추구하고 있다. 기업들이 살아남을 수 있는 구체적 길은 생존을 위한 한 가지 이상의 생존무기를 가지는 것이다. 첫째, 기술경쟁력을 가진 기업은 확실한 생존이 보장된다. 21세기 유망기술은 “정보”와 “생명” “환경·에너지” 관련기술이다. 둘째는 기술발전에 따라 새롭게 등장하는 시장을 선 점하는 것이다. 인터넷이 여기에 해당되며, 이전까지 상상 할 수 없었던 새로운 시장을 만들어 내고 있다. 셋째는 경영혁신을 통해 해당분야에서 세계 최고의 원가 경쟁력을 가진 기업이 되는 것이다. 뒤따라가는 기업경영은 백전백패 하고 광속시대에 걸 맞는 새 틀을 마련해야하며, 뉴 트렌트를 잡아야 생존전략 방안으로 전략적 제휴(strategic alliance)가 활발하게 이루어지고 있다. 그 중에서 전자 반도체의 전략적 제휴는 어떠한 경제적 파급 효과를 나타나는가를 파악하는데 일차적 목적을 두었다.

## II. 전략적 제휴가 이루어지는 이유

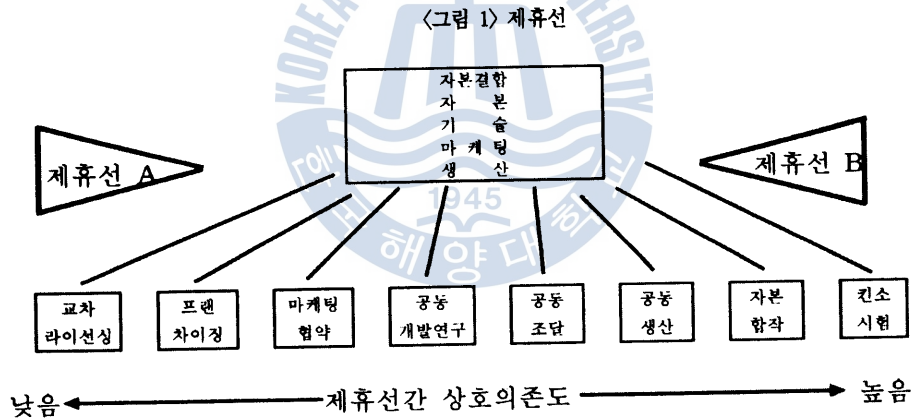
엄밀한 의미에서 전략적 제휴란 경쟁관계에 있는 기업들간에 특정사업 및 업무 분야에 걸쳐 협력관계를 맺는 것을 일컫는다. 전략적 제휴는 제휴 선간의 상호 보완적인 제품, 시설, 기능 및 기술을 공유하고자 하는 목적을 띤 일련의 벤처(Venture)다. 전략적 제휴는 대체로 다음과 같은 속성을 띤다.

책임의 공유(Shared responsibility), 개별 구성원 아이덴티티(identity 유지), 자원의 지속적 이전, 시너지(synergy) 창출, 제휴 프로젝트의 개별성, 연락기능(licensing skills)의 강조, 등이다. 전략적 제휴의 특징은 과거에는 합작투자등 이며 전략적 제휴의 동인이 된 국제환경의 주요 변화를 들면 다음과 같다. 시장의 글로벌 화, 소비자의 욕구와 기호의 범 세계적 균질화, 연구개발 신제품개발, 제조설비 등 고정비용의 급격한 상승, 급격한 기술변화와 제품 수명주기의 단축 국가간 및 기업간 기술격차의 해소, 선진국에서의 보호주의자들의 압력강화, 경제적 규제완화(economic deregulation), 공기업의 민영화에 따른 새로운 산업 출현, 일본이 경제대국으로 부상함에 따른 세계경쟁의 상극 구조화, 정보통신 기술의 발달, 등으로 전략적 제휴는 기술개발 경쟁의 가속화, 경제구조의 블록화 및 글로벌 화라는 환경변화에 대응하기 위한 생존전략이다. 전략적 제휴가 선호되는 글로벌 시장에서 선두주자가 되기 위해서이며 자원과 위협의 공유, 본국시장

에서의 경쟁 위협의 봉쇄, 기술과 시장의 급속한 통합에의 대응, 제품도입주기의 단축, 주요 시장 접근과 입지확보, 국제표준규격확립, 소비자 욕구와 기호의 '범세계적인 균질화', 보호장벽회피, 정치적 보험의 기능도 된다.

### III. 전략적 제휴의 범주 와 사례

제휴참여 기업의 목적 및 목표에 따라 다양한 형태의 전략적 제휴가 가능하다. 가장 보편적인 제휴방식으로는 제휴합작 벤처(alliance joint venture AJV), 지분참여 및 업무제휴(공동생산, 공동연구개발, 공동 마케팅 등)를 들 수 있으며 이들 제휴옵션의 공통점은 제휴에 참가하는 기업들 자신의 약점을 커버할 수 있도록 디자인 된 것이다. 즉 기업자신이 취약부분(기술, 마케팅, 유통망, 자본)을 보완해 줄 수 있는 파트너를 찾아 제휴를 맺는 것이다.



자료: B. G. James, 1985

#### 주요제휴 사례

주요제휴 사례를 고찰하면① 생산 및 기술제휴로는 미국 모토롤라 일본 도시바 사나 제휴관계에서 도시바가 DRAM, 모토롤라가 마이크로 프로세서(M P U)기술을 제공하여 일본에 건설된 합작공장에서 생산한 제품을 상호 공급하는 제휴로써, 모토롤라는 일본시장의 성공적인 진출과 함께, 80년대 후반 생산 종결되었던 DRAM을 공 제휴로

공급받아 자사브랜드로 판매하고 도시바는 모토롤라와 M P U의 세컨드 소싱 계약을 체결, M P U시장에의 참여 및 안정적 공급도모 하므로 제휴업체의 확고한 기술 우위 존재와 신뢰관계의 구축을 통해 제휴효과를 거두고 있다 ②신제품에 대한 공동개발로 확대하는 제휴와 생산제휴(OEM)는 일본 히다찌사와 금성 일렉트론 사에서는 투자 부담을 경감하고 자사에서 상환되지 않는 제품이나 자사에서 생산되더라도 안정적인 공급을 수요변동에 대응하기 위하여 제휴함으로써, 히다찌는 금성 일렉트론에 1M, 4M DRAM기술을 제공하고, OEM공급을 받아 자사 브랜드로 판매, 투자부담 경감 및 안정적인 공급 가능하게 되었고 금성 일렉트론은 히다찌로부터 1M, 4M DRAM기술을 이전 받음과 동시에 생산설비를 이용하여 동제품을 추가 생산하여 OEM공급함으로써 제휴산업체의 기술 및 생산 면에서의 우위 요인을 바탕으로 제휴하여 안정적인 수급 확보 및 첨단기술 도입을 모색하였고 ③생산제휴로써는 미국 Texas Instrument사와 일본 신호제강소 제휴관계로 TI사는 신호제강소와 공동으로 일본에 반도체합작회사 KTI 세미컨덕터 (총 투자액 550억엔)를 설립하여 CMOS, ASIC로 직 부품 등을 생산하고 TI사는 합작사에서 생산되는 제품을 공급받아 TI브랜드로 판매함으로써 투자부담 경감 및 생산능력의 확대 도모함으로써 신호제강소는 반도체관련 기술을 TI사로부터 받아들여 신규사업에 진입하여 생산제휴를 통해 투자부담 경감 및 신규사업에 진입할 수 있는 계기를 마련하였다.

또한, ④공동 개발로써는 개발코스트가 커짐에 따라 이에 따른 제반 부담을 완화하기 위하여 업체간 국제공동개발을 지향, 특히 차세대 DRAM, SRAM 및 신규 수요로 기대되고 있는 플래시메모리 분야에서 활발히 진행 중에 있으며 256메가 DRAM은 도시바-IBM-SIMENS(개발비 70억 달러 공동투자, 생산비용 각 7.5억 달러씩 분담하여 투자), 히다찌-TI와 공동 개발하고 차세대 S RAM은 일본 전기AT&T, 후지쯔-모셀일이 생산하고 플래시 메모리는 일본 전기 AT&T, 도시바-IBM, 후지쯔, -AMD, 사프-INTEL생산하며 신형 반도체 칩 개발(서머셀 동맹)은 IBM-모토롤라-애플사가 생산하여 반도체의 신기술개발에 따른 코스트 및 리스크 부담의 완화, 미국, 유럽, 일본의 내수시장에서 배타적 경쟁력 확보를 목적으로 제휴가 이루어졌다.

#### IV. 반도체산업의 전략적 제휴와 향후전망

반도체산업의 특성으로서는 타산업과 비교 할 수 없을 정도의 고도 성장산업이라는 점이다.(표1) 과 같이 주요산업별 성장률을 비교해 볼 때 반도체 산업의 성장률이 월등함을 알 수 있다. 또한 세계 반도체 시장수요 예측을 보아도 (표2)와 같이 2000년까

〈그림 1〉 주요산업별 성장률비교(1990~1995년)

(단위 : %)

구 분	반 도 체	전 자	통 신	자 동 차	컴 퓨 터
상 장 률	16.8	7.2	8.9	2.0	6.8

〈그림 2〉 세계반도체 시장규모(1990~2000년)

(단위 : 억 달러%)

구 분	1990년	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	연평균 성장률 (1995~2000)
전 체	548	1,413	1,630	1,823	2,131	2,798	2,904	15.5
메 모 리	128	501	586	647	779	935	1,105	17.1
마이크로	420	912	1,044	1,823	1,355	1,563	1,799	14.7

지의 연평균 성장률이 15.5%를 웃돌아 그 성장속도가 매우 빠름을 알 수 있다.

아울러 반도체 산업은 부가가치가 매우 높은 산업의 특성을 갖는다. 사업의 재료비 비중은 가전 부문 62%, 컴퓨터부문65%, 통신부문 60%에 비해 반도체 부분은 17.5%밖에 되지 않는 반면, 개발비 비율은 상대적으로 높아(가전 4.5% 컴퓨터 3.8%통신 13%, 반도체 11.7%)Kg당 가격이 타제품에 비해 월등히 높음을 알 수 있다.

〈그림 3〉 반도체 산업의 고부가가치 특성

구 분	반 도 체	가 전	컴 퓨 터	통 신
재료비 비중	17.5%	62%	65%	60%
개발비 비중	14.8%	4.5%	3.8%	13%
Kg당 가격 (달러)	16M디램 23000	ColorTV 35	슈퍼컴퓨터 3,750	무선전화기 200

## V. 반도체 산업의 제휴현황

현재 세계 반도체 업계에선 한편으로는 경쟁하면서도 또 다른 한편으로는 협력 관계를 유지하는 현상이 나타나고 있다. 이는 막대한 자금이 요구되는 기술개발비를 절약하고 기술과 제조시설을 상호공유하며 중복투자를 방지하기 위한 것으로 풀이된다.



위의 제휴업체들은 다국적 경영으로 조직을 개편하고 시장 점유율에 그 지위의 강화 및 유지를 통해 기업인수, 기술 및 생산능력, 그리고 자본참여 등의 다각적 방안으로 제휴를 모색하고 있다.

〈표 5〉 반도체 분야의 제휴현황

제 휴 업 체	제 휴 내 용
(미)IBM - (일)도시바 - (독)지멘스	256메가 D램 공동개발
(미)IT - (일)히타치	64메가 D램 공동개발
(미)AT&T - (일)NEC	S램 기술교환
(미)SUN - (일)후지쓰	마이크로 프로세스(MPU)공동개발
(미)DEC - (일)미쓰비시전기	마이크로 프로세스 공동개발
(미)램트론 - (일)히타치	고성능메모리 칩 공동개발.판매
(미)AMD - (독)지멘스 - (일)후지쓰	플래쉬 메모리 공동개발
(일)도시바 - (미)모토로라,NC	차세대IC(집적회로)공동개발
(일)미쓰비시 - (미)롭슨	플래시 메모리 공동개발
(일)산요 - (불)롭슨	MPEG기술개발
(한)삼성전자 - (미)MT	메모리 기술교환
(한)삼성전자 - (일)도시바	플래쉬 메모리 기술 및 생산제휴
(한)현대전자 - (일)후지쓰	D램 공동생산 및 개발
(한)금성일렉트론 - (일)히타치	D램 생산계약과 판매
(한)금성 일렉트론 - (독)지멘스	MPU기술제휴

## VI. 국가차원의 제휴전략 추진현황

### 가. 미국 : SEMATECH (Semiconductor Manufacturing Technology)

#### 1) 목적

미국반도체업체의 제조기술 경쟁력 확보를 목적으로 국가차원에서 정부-기업간 제휴를 통하여 4M DRAM(1990), 16M DRAM(1993), 64M DRAM(최종)의 제조기술확보를

#### 2) 투자현황

1988-1993년간 총 15억 달러 투자

### 3) 추진현황

- 반도체 장치 및 재료업체와의 연결을 위해 SEMI/SRMATECH를 통해 IBM으로부터 4M DRAM 기술을 제공받음.
- US Memories\*와 긴밀한 관계를 유지하면서 JESSI 와 협력 모색

\*메모리반도체의 대일 의존을 탈피하고 미국 내 공급선을 안정적으로 확보하기 위하여 IBM을 중심으로 추진되었던 US Memories는 목표 기금액 10억 달러의 유치 실패로 설립 취소 (90. 1월)

### 나. 일 본 : TRON Project

#### 1) 목 적

중래 미국의 컴퓨터와는 달리 독자적인 일본어 처리를 위한 일본식 컴퓨터 개발이라는 목표 하에 일본 고유의 MPU, OS 개발 추진.

#### 2) 추진현황

후지쓰, 미쓰비시, 일본 IBM 등 95개 사가 참여하고 있으며, 지멘스, 올리벤티, 에릭슨 등의 외국기업들도 TRON 협의회설립준비위원회에 참여

### 다. 유럽 : ESPRIT(유럽 정보 기술연구 개별계획)

#### 1) 목 적

EC 최초의 공동연구계획안 ESPRIT(The European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology)는 EC 주요 전자업체 'Bic 12'가 EC 전자산업의 경쟁력 제고를 위한 공동 개발을 목적으로 10년간 (1984~9년)을 추진기간으로 설립 (82. 2월)

#### 2) 투자현황

회원국과 참여기업, 연구기관이 각각 50%씩 연구비분담.

#### 3) 연구분야

첨단 마이크로일렉트로닉스, 소프트웨어, 첨단정보처리, 사무시스템, CIM 등 5개 분야



\*반도체조립기술, CAD장비, 반도체신소재, 첨단 디스 플레이 등의 연구 포함(등 계획에 배정된 기금은 총예산의 25%)

#### 4) 추진현황

88년 말까지 226개 프로젝트 추진

○제1단계(1984-87년)

빅 12' 는 1986년 중 ESPRIT예산의 50%에 해당하는 16 개 프로젝트에 참여(10억 달러의 투자비 지출)

○제2단계(1987-94년)

제1단계에서 연구된 성과의 상품화에 중점을 두고 반도체 특수 집적 회로 (ASIC) 관련연구 추가(총예산 21억 달러로 책정)

#### 5) 추진성과

EC 기업들에 대하여 미, 일 기업들과 경쟁할 수 있는 장을 제공하고, 분할 된 시장을 통합함으로써 정보산업분야의 표준화 가속

### 라. 유럽 : JESSI (범 유럽반도체공동연구개발계획)

#### 1)목적

JESSI (Joint European Submicron Silicon Initiative)는 실리콘에 기초를 둔 Microelectronics 와 System과의 응용통합을 위한 차세대 칩 개발을 목표로 한 연구개발 프로그램

○1989-96년까지 8년간 4M DRAM(1990), 16M DRAM(1993), 64M DRAM(1996) 개발 목표

#### 2) 참여업체

유럽 6개국(독, 프, 영, 이, 네, 벨)의 연구기관 및 29개 민간기업(지멘스, 필립스, SGS-톰슨 등 EC 3대 반도체업체 중심) 참여. 총예산 50억 달러, 투입인원 연 22,000명

\*EC 역외업체는 참여불허가 원칙이었으나, IBM과 지멘스 간 공동 개발제의를 계기로 IBM참여를 허용(1990년). 그후 일본 후지쓰도 영국 ICL 인수 후 ICL의 일부 프로젝트(CAD) 참여 허용됨.

다국적기업의 반도체산업에 대한 전략적 제휴에 관한 고찰

### 3) 연구분야

기술개발, 장치·재료, 응용, 기초의 4개 분야로 EUREKA (European Research Coordination Agency)와 연계 추진

### 4) 추진현황

회사별로 연구분담 추진

EPROM (SGS-톰슨), DRAM(지멘스), SRAM(필립스), CAD 및 ISDN (플래시이).  
이중 필립스는 영업부진으로 SRAM개발에서 철수, 개발중단

○제1단계(1989~91년)

120여개 회원(연 3,000명) 참여하여 70여개 프로젝트 추진(6억 달러 투입). 참여업체 50%, 해당 정부 40%, EC 10% 분담

○제2단계(1992~ )

제1단계의 경험을 바탕으로 60여개 중점연구과제(HDTV, 디지털 음성방송, 광역 통신 등)를 선정, 이 제품에 사용되는 칩 세트 개발과 특수 집적회로(ASIC) 개발에 주력할 예정

## Ⅵ. 최근 국제 전략적 제휴의 특성

기업규모(대기업-중소기업), 기술개발(선발기업-후발기업), 시장개척(매도기업-매수기업)면에서의 수직적 관계 ==>수평적 또는 경합관계에 있는 기업간의 협력관계로 발전

가. 기업간의 협력빈도 대폭적인 증가추세

-신제품, 신기술개발에 따른 리스크 및 투자비의 과중한 부담으로 개발의 성공 여부에 관계없이 업체간 제휴추진 확대

○첨단기술이 요구되고 투자개발비 부담이 클수록 즉, 진입장벽이 높은 산업일수록 제휴 활발

○1980년대부터 일본기업의 대공세에 밀린 미국, 유럽의 다국적기업이 공동이익을 추구하기 위한 전략적 제휴 모색 확대

나. 제휴범위의 확대

-종전에는 기술전이나 도입, 신 시장개척 등 제한된 범주에서 출발하였으나, 공동연구개발이나 범 세계시장에서의 신 사업 창출 및 판매제휴로 확대되는 추세임

○ 진행여부에 따라 생산, 판매, 조달제휴로 확대되고 이들 제휴과정이 원만하게 진행될 경우 자본참가 형태로 확산됨.

다. 제휴형태는 복합적, 비 정형적 으로 변화

- 첨단기술산업에서는 복합적인 기술이 요구되므로 다양한 업종에 속한 기업간의 제휴가 불가피하게 전개 (예, 멀티미디어 산업)

라. 제휴상대는 주로 경제관계에 있는 세계정상기업으로 구성

- 제휴대상기업으로 종래 국제사업경험이나 능력이 부족한 한겨레기업에서 당해 산업분야에서 정상을 달리는 세계일류기업으로 구성

- 자사의 국내, 외 시장에서 경쟁력 제고 및 마켓 세어 확대를 위하여 경쟁 라이벌 기업과 제휴 일반화(INSEAD 조사, 라이벌 기업간 제휴:71%)

○미국-일본 반도체기업제휴, 미국(비 3대 항공사)-영국 BA 사 간 제휴

마. 선진국 정부에서도 기업간 제휴를 조장

1980년대부터 일본기업의 미국, 유럽의 다국적기업이 공동이익을 추구하기 위한 제휴를 확대하도록 정부에서 유도

○ 자신들이 우위에 있는 기술(제품)이나 시장에 전념하고, 부족한 부문은 경쟁기업간 협력이나 중소기업과의 계열화를 통해 보완

- 특히 기업간 협력과 계열화는 미국 정부의 반 트러스트 법 완화추세와 맞물려 더욱 확산되는 추세

○ 미 법무성 미국기업의 합병 및 제휴전략에 대해 방관적 태도를 견지

○ 장기적으로 기업집단 형성을 허용하는 방향으로 서면법이 개정되어야 한다는 주장 대두

바. 개도국 후 발 기업에 대한 견제 강화

- 동일 업종에 속한 복수 업체간 공동규격의 재정으로 개발 및 생산에서의 독과점체제 유지 도모→ 후 발 기업에 대한 진입 장벽 강화

○ 공동으로 기술, 제품개발에 선공하는 경우 제휴참여업체간 배타적 생산 및 판매 실시

사. 기업의 경영혁신활동과 동시에 제휴 전개

-세계경제의 불황심화에 따른 경쟁격화로 기업의 경쟁 열위, 취약부분에 대한 downsizing, restructuring등 경영 혁신 활동과 동시에 제휴진행

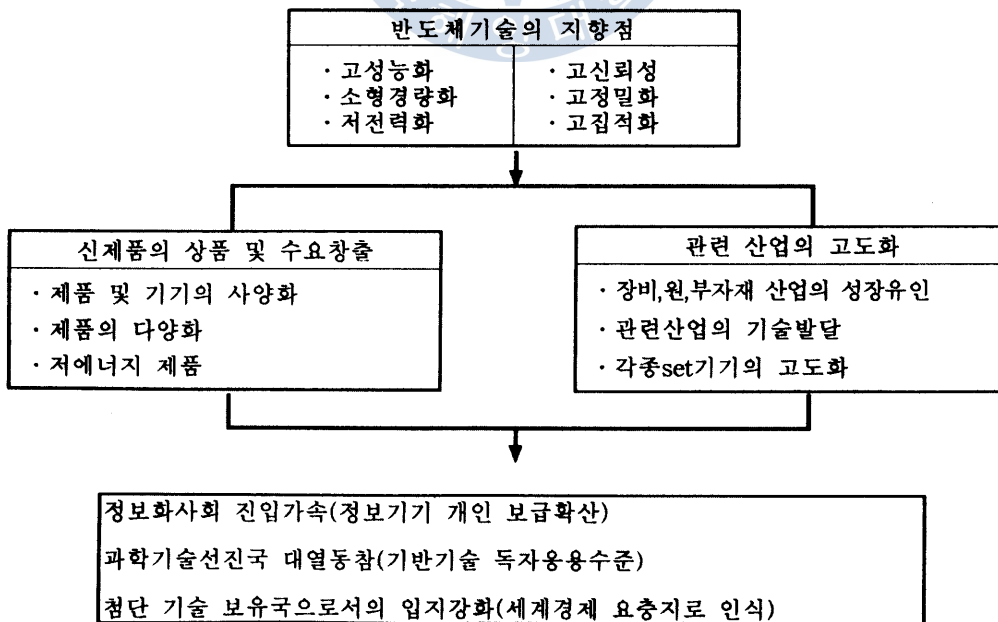
- 자신들이 우위에 있는 기술(제품)이나 시장에 전념
- 부족한 것은 경제기업간 또는 중소기업과의 계열화를 통해 보완

아. 제휴기간 확대추세

-제휴는 보통 7년 단위로 종결되지만 기술, 생산, 마케팅제휴 등으로 그 기간이 연장. 확대되어 가는 추세임

### 결론

시장규모가 거대하고 기술개발 및 성장속도가 빠른 산업이지만, 가격등락 폭이 클 뿐만 아니라 주기적으로 수급상의 불일치가 발생하는 특성을 가지고 있으며, 특히 기술개발 및 생산에 따른 고정비부담이 크고 시설투자의 경직성으로 퇴출 장벽(Exit barrier)이 상대적으로 높아 국제기업간 경쟁과 협력이 동시에 진행되어 기업간 협력을 통해 규모의 경제 및 학습효과를 도모하고, 현지기업과의 제휴를 통해 해당 시장으로의 침투 및 시장확대를 도모 하여야한다. 과점적 시장 구조하에서 선진국기업간



시장 세어 유지하고 후 발 기업의 신규진입을 저지하기 위해 연구개발 뿐만 아니라 자금, 경영 능력 면에서 상호보완적 협력을 통한제휴를 모색 해야한다. 반도체 기술은 고성능화, 고 신뢰성, 고 정밀화, 고집적화, 소형경량화, 저 전력화가 요구되는 첨단기술의 특성을 지님으로써 기술파급효과가 매우 크며, 제품 및 기기의 소형화, 제품의 다양화, 저 에너지 제품등 신 개념의 상품 및 수요창출 효과 또한 클뿐더러 정보화 사회진입을 가속화 하는데 없어서는 안될 기술적 요소를 제공하고 있다.

(그림 2 참조) 그림 2 반도체 기술이 파급효과

따라서 21세기 최고의 가장 유망산업인 정보 기기 산업의 핵심요소가 되는 반도체를 저렴하고 질 좋은 제품으로 공급하는 것이야 말로 관련산업의 국제 경쟁력 제고에 크게 기여 할 수 있다. (표 4참조)

표 1, 2, 3, 4를 토대로 앞으로 세계반도체 시장은 업체간 전략적 제휴가 더욱 가속화 되고 후 발 업체의 투자 또한 가속화 될 것이다. 차세대 기술의 발전속도 역시 더욱 빨라지고 또 다변화 될 것으로 보인다.

〈표 4〉 반도체 기술의 산업파급효과

(단위 : 억 달러)

	1990년	1995년	2000년	2005년
반도체성장률(%)	8.8	10.9	12.5	15.0
주요전자기기시장규모				
· 가 전	1,314	1,880	2,550	3,410
· 컴퓨터	1,081	1,294	1,830	2,500
· 통 신	945	1,384	1,880	2,550

## 참 고 문 헌

- 김철(1996) 다국적기업론, 법문사.
- 이 승영(1998) 국제마케팅, 일신사.
- 전 용욱(1990) 반도체산업의 다국적기업간 협력과 한국기업의 대응전략, 산업연구원  
조사 93-39,(1993) 전략적 제휴의 실태와 활용방안, 한국무역협회.
- Bleek, Joel and Ernst,David,(1991) "The Way to Win in Cross-Border Alliance", Harvard  
Business Review.
- Dodgson, Mark,(1993) *Technological Collaboration in Industry : Strategy,Policy and  
Internationalization in Innovation*, London: Loutledge.
- Hagedoorn, John and Schakenraad, Jos, (1991) "The Economic Effects of Strategic Partnership and  
Technology Cooperation." MERIT 91-003.
- Ohmac, K.,(1990) *The Borderless World : Power and Strategy in the Interlinked Economy.*

